



YDIV08-20362C1

20 - 36GHz 功分器
数据手册

四川益丰电子科技有限公司

Sichuan YiFeng Electronic Science & Technology Co., LTD

产品简介

YDIV08-20362C1 是一款高性能 GaAs MMIC 功分器芯片，工作频率 20 到 36 GHz。该芯片具有 0.4dB 的插入损耗，隔离度为 25dB。

关键技术指标

- 工作频段: 20 ~36 GHz
- 隔离度: 25dB
- 插入损耗: 0.4 dB
- 芯片尺寸: 1.0mm x 0.9mm

应用领域

- 通信
- 仪器仪表





YDIV08-20362C1
数据手册

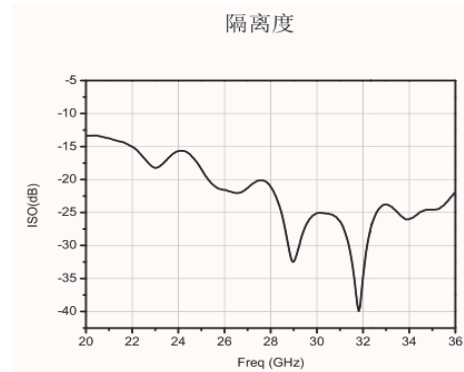
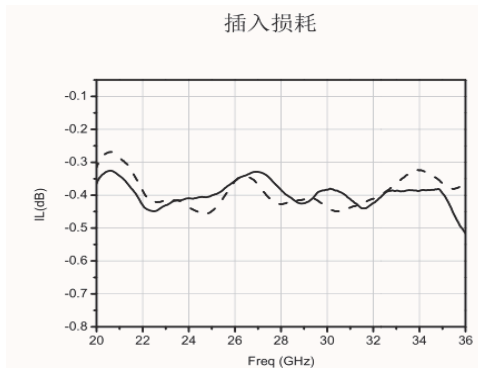
绝对额定最大值

最大输入功率	+27 dBm
工作温度	-55°C ~ 125°C
储存温度	-65°C ~ 150°C

电性能表 (TA=+25°C)

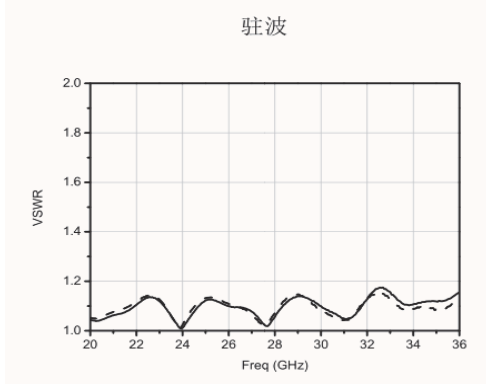
指标	最小值	典型值	最大值	单位
频率范围	20 – 36			GHz
输入驻波	-	1.1	-	-
输出驻波	-	1.1	-	-
插入损耗	-	0.4	-	dB
隔离度	-	25	-	dB

典型测试曲线

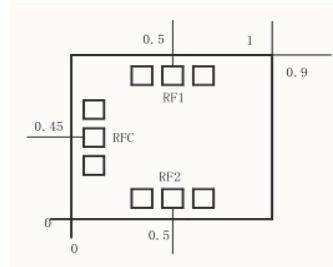




YDIV08-20362C1 数据手册



外形和端口尺寸 (mm)



注意事项

1. 芯片在干燥、氮气环境中存储，在超净环境中使用；
2. GaAs 材料较脆，不能触碰芯片表面，使用时必须小心；
3. 芯片用导电胶或合金烧结（合金温度不能超过 300℃，时间不能超过 30 秒），使之充分接地；
4. 芯片微波端口与基片间隙不超过 0.05mm，使用 $\Phi 25\mu\text{m}$ 双金丝键合，建议金丝长度 250~400 μm ；
5. 芯片微波端无隔直电容；
6. 芯片对静电敏感，在储存和使用过程中注意防静电。